



金属基板専用

金属基板専用N2リフローはんだ付け装置 RF-250N2

RF-250N2は熱容量の大きな、ホットプレート式リフローはんだ付け装置です。遠赤や熱風方式では難しい大 きな熱容量を必要とするセラミックやホーロー基板、それに鉄やアルミなど金属基板のリフローはんだ付けがで きます。

基板はホットプレートの上を直接キャリアバーに押されて(又はテフロン・シートに引かれて)スライドします。基 板を直にホットプレートから加熱するので、熱容量の大きな基板でも効率良く短時間に、高い温度精度でリフロー はんだ付けできます。

- 5ゾーンの加熱プレートにより、熱容量の大きなホーロー基板や金属基板のリフローはんだ付けが容易にできます。
- 最大150×150×5mmのワーク基板までリフローはんだ付けできます。
- 加熱ゾーン全てがPIDデジタル温度制御なので、高精度で安定した温度プロファイルが得られます。
- 最高400℃まで加熱でき、300℃以上の高温はんだも使用できます。

仕 様

•加熱部 :5ゾーン 幅150mm×長さ1000mm 入口高さ40mm

第1ゾーン: (W) 150×(L) 200mm 1.1kW プリヒート部

> 第2ゾーン: (W) 150×(L) 200mm 0.8kW 第3ゾーン: (W) 150×(L) 200mm 0.8kW

リフロ一部 第4ゾーン: (W) 150×(L) 200mm 1.1kW+IR1.0kW

アフターヒート部 第5ゾーン: (W) 150×(L) 200mm 0.8kW

加熱方式 : ホットプレート方式(第4ゾーンのみ上部IRヒーター併用)

温度制御:Max400°C P.I.D.温度調節器

・コンベア :キャリアバー(基板後押し金具)方式(間隔:200mm)

> 又はテフロン・シート・キャリア方式(146×150mm) 50~1000mm/min デジタル式スピード調節器 コンベア方向:右→左 又は 左→右(指定)

・センサー : 熱電対K(CA)(ホットプレート内) •冷 却 :出口側ファンによる強制空冷

•電 源 : 単相200V 約6kW (220V/240V仕様も可) 50/60Hz

•N2供給量 :約20~100ℓ/min

•安全装置 :漏電/過電流ブレーカー。非常停止スイッチ。

警報出力(過温/低温/ヒーター断線)

チェーンコンベア・トルクリミッタ。

•外形寸法 $: (W) 1680 \times (D) 550 \times (H) 1070 mm$

重量 :約170kg

適合基板

セラミック基板、ホーロー基板、金属基板、多層プリント 回路基板。その他熱容量の大きな片面実装SMT基板。

寸法 : 25×25mm~150×150mm

板厚:0.8~5mm 高さ : Max40mm

- ・ホーロー基板や金属基板のリフローはんだ付け。
- 放熱器、金属ブロックヘチップ部品のはんだ付け。
- 300℃以上の高温はんだ付け。
- その他熱容量の大きなワークへの加熱作業。

短 所

- ・片面実装基板のみ使用可能です。
- 加熱すると反りのでる樹脂基板は使用できません。

オプション

•動作表示灯

本仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社日本パルス技術研究所

前橋事業所/〒379-2122 http://www.jpl.co.jp/

社/〒372-0804 群馬県伊勢崎市稲荷町425-3 TEL 0270-23-1031 群馬県前橋市駒形町506-3 TEL 027-266-6381 info@jpl.co.jp FAX 0270-23-1943